

DRILL CHART							
SYM	DIAM	TOL	QTY	NOTE			
♦	0.200 mm		4				
×	1.000 mm		2	NON-PLATED			
+	1.400 mm		2	NON-PLATED			
Ø	2.200 mm		4	NON-PLATED			
	TOTAL	-	12				

MATERIALE TIPOLOGIA CIRCUITO SUPPORTO SPESSORE RAME ☐ MONOFACCIA ☐ FR2 X LATI ESTERNI X FR4 M DOPPIA FACCIA LATI INTERNI ☐ MULTISTRATO SPESSORE SUPPORTO ALTRO N°LAYERS 2 1 mm TRATTAMENTI RAME DI RIPORTO ELETTROLITICO MIN. 20u ☐PLACC.ELETT. SURFUSO Sn/Pb 60/40-70/30 Sp.10-20u ☐PLACC.ELETT. RIFUSO Sn/Pb 60/40-70/30 Sp. 4-15u RAME PASSIVATO MHOT AIR LEVELING \square DORATURA(D=140±vPN) □ 0.3u □ 0.6u □ 1,0u □ 1,3u □ 2,0u BISELLATURA NUMERO DEI CONTATTI DEPOSITO DI GRAFITE NUMERO DEI CONTATTI SOLDER RESIST SERIGRAFIA SERIGRAFICO Sp. XLATO COMP.COLORE BIANCO XFOTOGRAFICO Sp. 13-100u XLATO SALD. COLORE BIANCO ☐COVER LAYERSp. 25-76u

TABELLA DEI FORI CON LAVORAZ. PARTICOLARI				FILES DI DOCUMENTAZIONE ASSOCIATI PER LA LAVORAZIONE	
TIPO	ø MET.	ø N.MET.	Q.TA'	LAYER BOT	X 23-319-0.BOT
Α				LAYER TOP	X 23-319-0.TOP
В				LAYER PWR	
С				LAYER GND	
D				SERIG. BOT	💢 23-319-0.SSB
E				SERIG. TOP	💢 23-319-0SST
F				LAYER IN1	
G				LAYER IN2	
Н				LAYER IN3	
ı				LAYER IN4	
L				RESIST BOT	💢 23-319-0.SMB
М				RESIST TOP	💢 23-319-0.SMT
NOTE PARTICOLARI				PAST BOT	X 23-319-0.SPB
				PAST TOP	X 23-319-0.SPT
				LAYER FOR.	×
				DRILL CHART	X 23-319-0.DRD
				DRILL TAPE	∑ 23-319-0.TAP
TUTTI I FORI NON INDICATI DEVONO				MECC.DRW.	□PF23-319-0.DWG
ESSERE METALLIZATI					

